

승 인 원

부품명	Chip Antenna	제품이미지
부품PN	ACS2450ICAMEB	IMEBO5k
사용자	디젠	205k
SEC CODE		상측면
Revision	VER.1.0 12월 10일	
제조사	파트론	하측면

MSL	LEAD FREE	BFRs-Free, Halogen-Free
MSL 1	LEAD-FREE	BFRs/CFRs/PVC-Free

기안	개발팀장	품질팀장
기한	[결재]	[합의]
김홍기	with	STER
김홍기	전찬익	민남식
12/10	12/10	12/11

Ver 1.0 (2014.12.12) 1/32 Page



- 목 차 -

※ 표지		1 p	Э
※ 목차		2 p	р
1. 이력 관리		3 p	р
2. 부품의 개요	2 및 치수규격	4 p	Э
3. 중점 관리 형	항목	4 p	Э
4. 전기적 특성		5 p	Э
5. 시험 방법		10 p	р
6. 내부 회로 구	구성도	12 p	р
7. 기본 동작 및	및 응용 방식	12 p	р
8. 측정 지그 시	나양	13 r	р
9. 표준 열경화	조건 (REFLOW PROFILE)	14 p	р
	성적서	·	
	조건		
12. 기구적 특성		18 ן	р
13. 구조 및 재	질	20	р
14. 주의 사항		21	p
15. 포장 사양		22	р
16. 관리 공정도		26	p
17. 유해물질 성	<u> </u>	29	р



1. 이력 관리

개정 번호	개발자	변경 사항	변경 일자
Ver 1.0	김홍기	승인원 제정	2014.12.10

Ver 1.0 (2014.12.12) 3/32 Page



2. 부품의 개요 및 치수 규격

2.1 부품개요

본 제품은 유전체 무선 통신 기기 내장형 칩 안테나로 직방의 형상을 갖는 유전체에 e(Ag) 도금으로 패턴을 형성하여 특성을 구현한다.

2.2 부품 치수규격

형 태	Only Bulk Ceramic					
-U TI	Dielectric Block 전극 Paste		Mg₂SiO₄(Magnesium Silicate)			
재 질				은(Ag)	
	L = 9.0 ± 0.1 (CPK:2.79)		Ag Paste			
크 기 [mm]		3.0 ± 0.1 (:2.28)				
		T = 1.2 ± 0.1 (CPK:2.38)		L		
평탄도	0.04 (소체기준)			05k	T	1
MSL LEVEL	MSL L	EVEL 1		W		
ESD LEVEL		V 이상 LASS 3B)	Dielectric Block			
Version	Revision 1.0		Top-Side View		Bottom-S	ide View
저기저 든서	특성	VSWR(CTF)	주 기	시 료 수	СРК	비고
전기적 특성 (CTF)	2400MHz	1.0 ~ 3.0:1	전수검사	전수	8.53	4,6,15 Page
	2485MHz	1.0 ~ 3.0:1	전수검사	전수	7.86	4,6,15 Page

3. 중점 관리 항목(💿)

- 아래 항목에 대하여 중점관리 항목으로 지정하여 관리한다.

제품의 CTQ 항목	SPEC	검사주기 또는 시료수	측정 계측기
소성온도	1350 <u>+</u> 15℃	1일 3회 검사	온도센서
건조온도	200 <u>+</u> 15℃	1일 3회 검사	온도센서
소부로온도	900 <u>+</u> 25℃	1일 3회 검사	온도센서

٠	제품의 CTF 항목📀	지정 사유
	단품 측정 SWR	제품의 전기적 특성을 분별하는 주요 변수임
	단품 측정 치수	치수 정밀도가 칩 안테나의 특성의 핵심적 항목임

- 아래 항목에 대하여 주의를 요함.

항 목	내 용
보 관	상온에 장시간 보관 시 밀봉하여 보관
동 작	임의의 설계 변경 시 특성이 변경될 수 있음

Ver 1.0 (2014.12.12) 4/32 Page



4. 전기적 특성

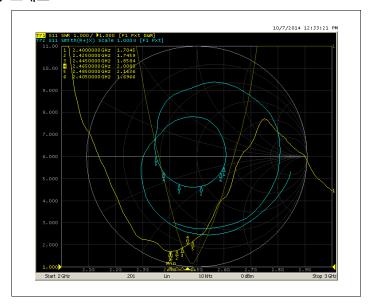
4.1 시료 실장 측정

	항	목	특 성	
Frequency Range [MHz]				2400 ~2485
	SWR	[Max]	3.0 : 1 (Typ 2.5 : 1)	
Input Impedance $[\Omega]$				50 Ohm
	Polariz	ation		Linear
	Total Gair	n (Peak / /	Avg) [dBi]	-2.05 / -7.48
		Theta	Peak	-3.92
	Azimuth	meta	Average	-8.72
	Azimum	Phi	Peak	-3.00
			Average	-9.74
		Theta	Peak	-6.04
Gain [dBi]	_, ,,		Average	-10.94
	Elevation 1	Phi	Peak	0.89
			Average	-4.87
			Peak	-0.31
	Elevation 2	Theta	Average	-5.19
		Phi	Peak	-3.71
			Average	-9.15

Ver 1.0 (2014.12.12) 5/32 Page



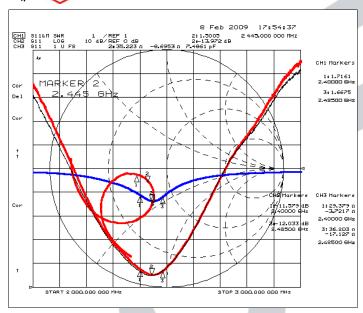
4.2 시료 실장 측정 그래프



4.3 수동 지그 측정

항 목	특 성
Frequency Range [MHz]	2400 ~ 2485
Lower frequency(2400 MHz) SWR [Min~Max]	1.0 ~ 3.0 : 1 (Typ 2.0 : 1)
Upper frequency(2485 MHz) SWR [Min~Max]	1.0 ~ 3.0 : 1 (Typ 2.0 : 1)

4.4 수동 지그 측정 그래프 📀



Ver 1.0 (2014.12.12) 6/32 Page



4.5 방사 패턴

Azimuth Plane	Elevation1 Plane	Elevation2 Plane	
270° 90°	90° 180°	270° — 90° — 90° — 180°	
Theta	Vertical field of measured plane		
Phi	Horizontal field of measured plane		



Ver 1.0 (2014.12.12) 7/32 Page





5. 시험 방법

5.1 SWR / Return Loss

Network Analyzer를 이용하여 SWR/Return Loss를 측정하며 표본 샘플을 선별 수동 측정 지그 또는 자동화 검사장비를 이용하여 양품과 불량품을 선별한다.

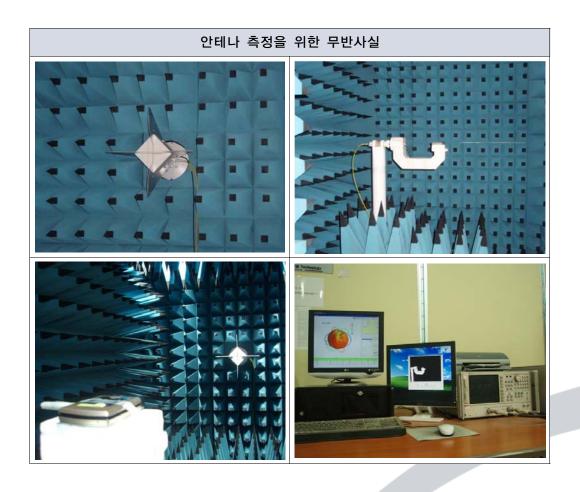
	시료 측정 조건	수동 지그 측정 조건
Network Analyzer	Agilent HP8753E or Advantest R3765CH	Agilent HP8753E or Advantest R3765CH
Cable	RF cable (300 mm)	RF cable (300 mm)
Test condition		CLUB CLUB CLUB CLUB CLUB CLUB CLUB CLUB

Ver 1.0 (2014.12.12) 8/32 Page

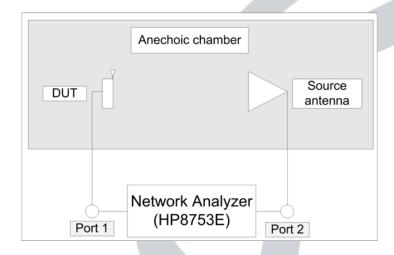


5.2 이득

당사가 보유한 전파 무반사실에서 상기 4.1에서 측정된 시료를 이용하여 안테나 이득을 측정한다.



5.3 이득 측정을 위한 회로 구성도

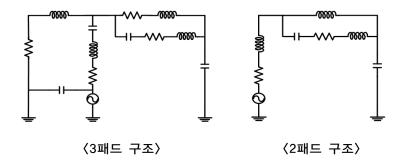


Ver 1.0 (2014.12.12) 9/32 Page



6. 내부 회로 구성도

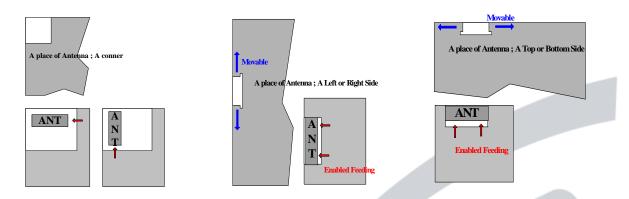
본 제품은 유전체를 재료로 한 직방형의 소체 표면에 은(Ag) 패턴의 구조적인 변경을 통하여 아래와 같은 구조적인 등가회로의 매칭 값을 조절하여 성능을 구현하는 RF 부품이다.



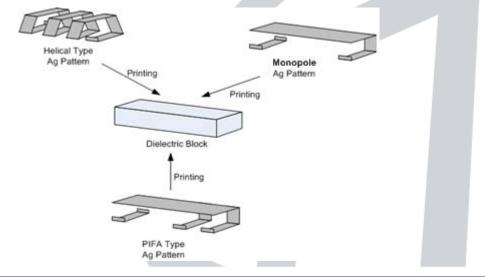
7. 기본 동작 및 응용 방식

본 제품은 무선 통신 기기 내장형 유전체 칩 안테나로 전송선로를 따라 진행해 온 전기적 신호를 자유공간파(FREE SPACE WAVE) 로 변환하는 장치이다.

본 제품은 원하는 어떠한 위치에도 실장이 가능하며 실장 조건에 따라 그 설계를 달리 한다. 다만 본 제품은 방사 부품으로 주변 경계 조건에 따라 그 특성을 달리 하므로 위치 선정에 각별한 주의를 기울여야 한다.



본 제품은 실장 주변 조건에 맞추어 아래와 같이 다양한 안테나 형태로 설계 변경이 용이하다.



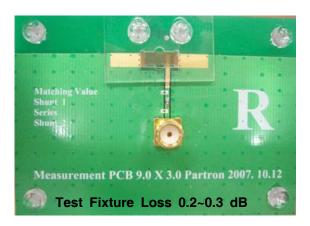
Ver 1.0 (2014.12.12) 10/32 Page



8. 측정 지그 사양

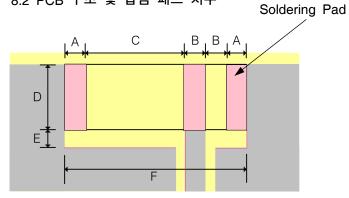
8.1 수동 측정 지그와 그라운드 조건

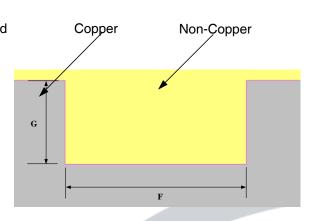




※ Ev B'd 와 수동 측정 지그는 동일함.(Ev B'd는 접촉 방식이 납땜, 수동 측정 지그는 동편 접촉 방식)







Top Layout

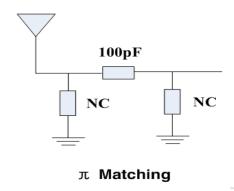
Bottom Pattern

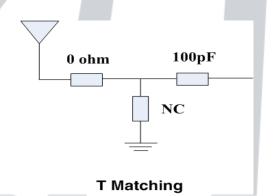
Parameter	Α	В	С	D	Е	F	G
Value[mm]	1.1	1.0	5.0	3.2	1.0	9.2	4.2

Unit; mm

Unless specified tolerances are ±0.05

8.3 매칭 회로와 기본값



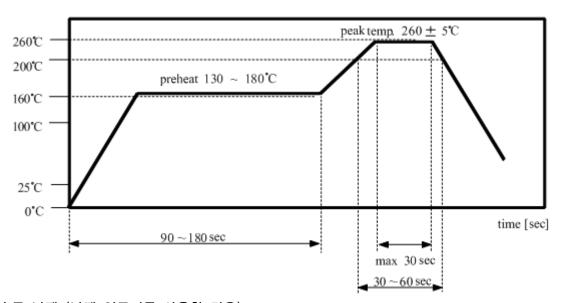


Ver 1.0 (2014.12.12) 11/32 Page



9. 표준 열경화 조건(REFLOW PROFILE)

9.1 표준 열경화(Reflow) 조건

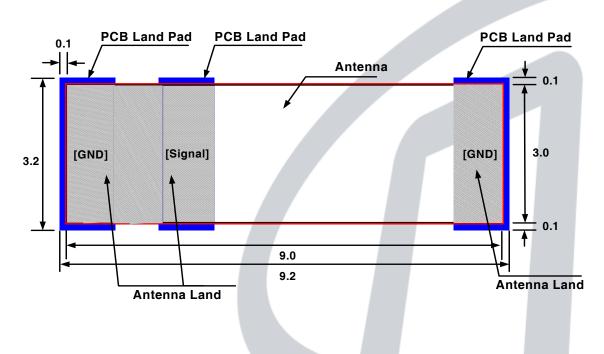


9.2 수동 납땜 (납땜 인두기를 사용할 경우)

예 열: 120 $^{\circ}$ / 시 $^{\circ}$ 간: 60 $^{\circ}$ 300 sec. 인두온도: 340 $^{+}$ 5 $^{\circ}$ / 시 $^{\circ}$ 간: 각 단 최대 5 sec.

9.3 PCB 패턴 설계 제안

PCB 패드 패턴은 제시한 안테나의 패드 치수보다 아래 그림에서 보여지는 것과 같이 0.1 mm 이상 외각으로 확장된 형태로 설계된다.



Ver 1.0 (2014.12.12) 12/32 Page



10. 초기 검사 성적서

검사항목	Frequency [MHz]		치수 [mm]			
규격	SWR 3	SWR 3.0 Max			T 1001	
" ¬	2400 MHz	2485 MHz	$W = 3.0\pm0.1$	L = 9.0±0.1	T = 1.2±0.1	
1	1.71	1.66	3.03	9.02	1.21	
2	1.64	1.73	3.02	9.01	1.22	
3	1.64	1.72	3.02	9.02	1.22	
4	1.67	1.71	3.01	9.01	1.21	
5	1.65	1.73	3.02	8.99	1.24	
6	1.59	1.78	3.04	9.00	1.23	
7	1.77	1.59	3.01	9.03	1.22	
8	1.57	1.77	3.01	9.00	1.23	
9	1.57	1.80	3.04	9.02	1.23	
10	1.63	1.73	3.03	9.02	1.24	
11	1.65	1.78	3.02	9.01	1.21	
12	1.62	1.71	3.02	9.00	1.22	
13	1.58	1.78	3.04	8.99	1.21	
14	1.62	1.77	3.01	9.01	1.23	
15	1.70	1.64	3.01	9.01	1.24	
16	1.58	1.72	3.02	9.00	1.23	
17	1.58	1.74	3.01	9.01	1.22	
18	1.62	1.75	3.04	9.00	1.22	
19	1.65	1.71	3.03	9.02	1.21	
20	1.58	1.79	3.02	9.01	1.21	
Min	1.57	1.59	3.01	8.99	1.21	
Max	1.77	1.8	3.04	9.03	1.24	
Х	1.63	1.73	3.02	9.01	1.22	
σ	0.05	0.05	0.01	0.01	0.01	
Cpk	8.53	7.86	2.28	2.79	2.38	
판정	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	

Ver 1.0 (2014.12.12) 13/32 Page



11. 신뢰성 보증조건

11.1 환경 시험

항목	시 험 조 건	판정기준
PCT	+121±5 [℃] , RH=100%, 96 hr	
-40±3 [©] 에서 1시간 방치 후 시험온도 상태에서 측정		
저온방치	시험 후 4.3 항의 특성 규격을 만족해야 함	
+85±3 [℃] , RH 85%에서 1시간 방치 후 시험온도 상태에서 측정		
내습방치	+85±3 °C, RH 85%, 120 hr 방치	

11.2 열충격, 열경화 시험

항목	조 건	판정기준
열충격	조 건: -40±3 [℃] /min ↔ +85±3 [℃] /min 시험 CYCLE: 32 cycle 온도변환시간: 5 min 미만일 것	시험 후 4.3 항의 특성
열경화	Pre Heating : 200±5 °C, 30 ~ 60 sec Peak Heating : 260±5 °C, 30 sec Max 초기측정 후 1회, 환경시험 후 3회 실시	규격을 만족해야 함

11.3 기계적 시험

항목	조 건	판정기준
진동시험	주파수 : 10~500 Hz, 가속도 : 10×9.8 때 (G) Sweep time : 15 min, X.Y.Z each 5 times	
낙하시험	 조건: 152 cm에서 낙하 지그를 이용하여 18회 자유낙하 (6면 3회) 지그: 120±20 g 플라스틱 지그 사용 바닥: 콘크리트 또는 철판 	시험 후 4.3 항의 특성 규격을 만족해야 함

*진동 및 낙하시험은 Ev B'd 납땜하여 실시할 것

11.4 MSL LEVEL 시험

1) JEDEC J-STD-020C 조건

	Floor Life		Floor Life Soak Requirements		Requirements
	Time	Conditions	Time	Conditions	
1	Unlimited	= < 30°C / RH 85%	168+5 / -0	= < 85°C / RH 85%	

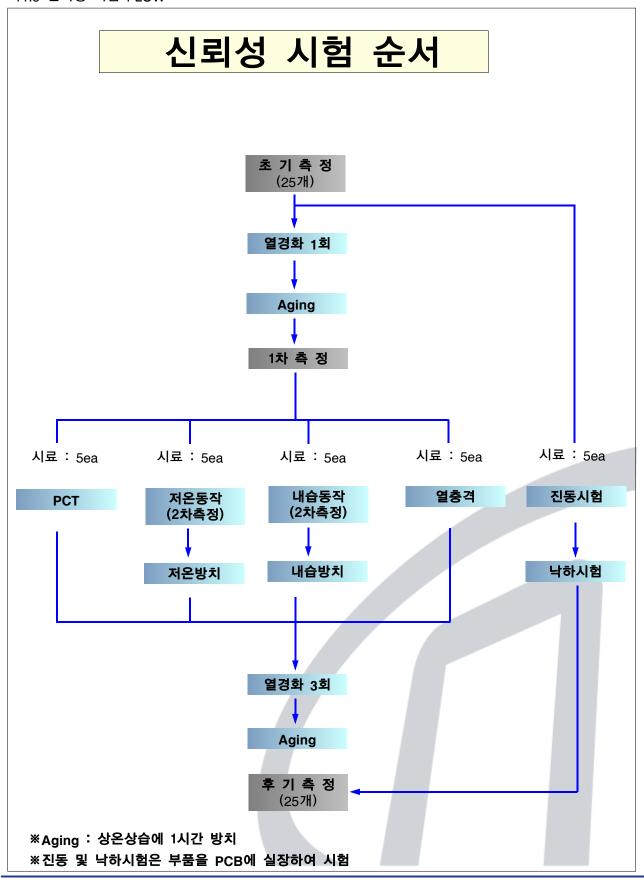
2) Test 조건

항목	조 건	비고
Soak Requirements	+85±3 [℃] , RH 85%, 168 hr 방치 후 Aging없이 Reflow 3회 실시	시험 후 4.3 항의 특성 규격을 만족해야 함

Ver 1.0 (2014.12.12) 14/32 Page



11.5 신뢰성 시험 FLOW

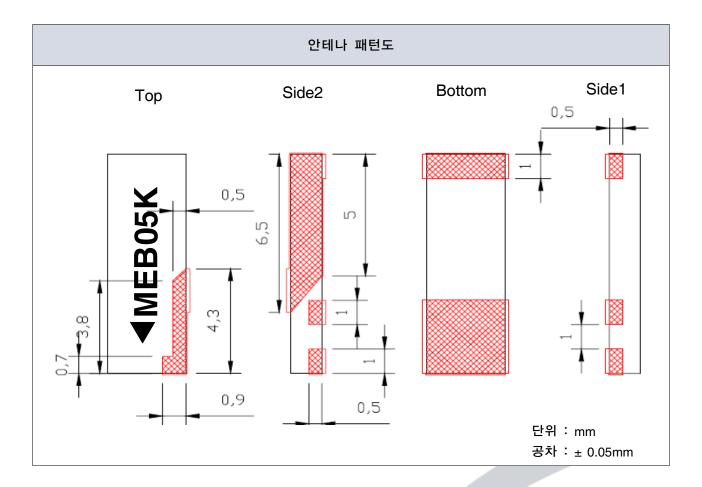


Ver 1.0 (2014.12.12) 15/32 Page

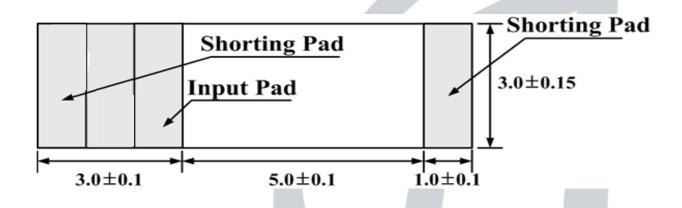


12. 기구적 특성

12.1 안테나 패턴 도면



12.2 Pin name



Ver 1.0 (2014.12.12) 16/32 Page



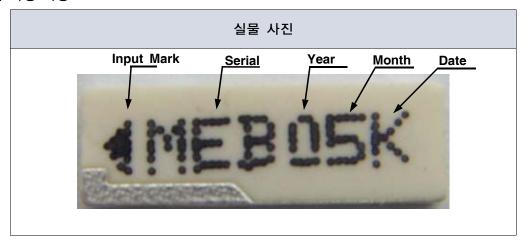
12.3 LOT 번호 표기법

0 <u>5</u> <u>K</u>

1 2 3

- ① 연도: 1-2001, 2-2002 ···· 9-2009, 0-2010 ····
- ② 월 : 1 1월, 2 2월 ···· A 10월, B 11월, C 12월 ····
- ③ 일 : 1-1일, 2-2일 ···· T 29일, U 30일, V 31일 ····

12.4 마킹 사양



■ MEB 0 5 K

1 2 3 4 5

- ① 안테나 급전 방향
- ② 모델 약자
- ③ 연도: 1-2001, 2-2002 ···· 9-2009, 0-2010 ····
- ④ 월 : 1 1월, 2 2월 ···· A 10월, B 11월, C 12월 ····
- ⑤ 일 : 1-1일, 2-2일 ···· T 29일, U 30일, V 31일 ····

12.5 마킹 종류

잉크 마킹 - 검정 잉크 사용

Ver 1.0 (2014.12.12) 17/32 Page

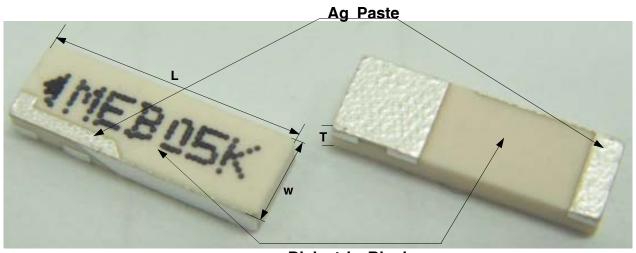


13. 구조 및 재질

13.1 구현방법

직방체의 형상을 갖는 유전체 소체에 은(Ag) 도금으로 패턴을 형성하여 특성을 구현함.

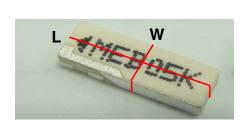
13.2 구 조

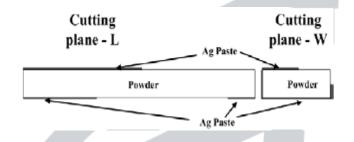


Top-Side View 13.3 내부 단면도

Dielectric Block

Bottom-Side View





13.4 재 질

구 분	재질	제조사	사양
유전체	POWDER	후지	
패턴	은(Ag) 도금	마이크로엠	인쇄두께 : TYP 10 🔎
패드	은(Ag) 도금	마이크로엠	인쇄두께 : Min 10 # (TYP 16~20 #)

Ver 1.0 (2014.12.12) 18/32 Page



14. 주의 사항

14.1 온도 조건

	온도범위	단위
사용온도	-40 ∼ +100	°C
보관온도	-40 ~ + 70	°C

14.2 시험 온도조건

	항목	온도범위	
사용온도	저온	-75 ℃에서 24시간 정상동작	
	고온	+150 ℃에서 24시간 정상동작	
보관온도	저온	-75 [℃] 에서 1000 hr 방치 시 정상동작	
	고온	+85 [℃] 에서 1000 hr 방치 시 정상동작	

^{*} 고온 방치 시 포장재 보관온도 문제로 85 ℃ 이상 불가함.



Ver 1.0 (2014.12.12) 19/32 Page

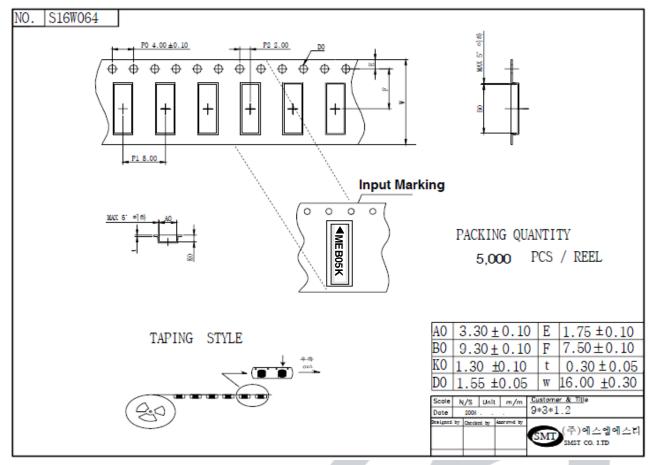


15. 포장 사양

15.1 Carrier/Reel 사양

품목	재질	표면저항	정전기 발생량	포장방식
Carrier	A-PET	Typical 10 ⁸ Ω	10V MAX	열 압착식
Cover 테이프	PET	Typical 10 ⁸ Ω	30V MAX	5 844
Reel	PS	Typical 10 ⁸ Ω	30V MAX	_

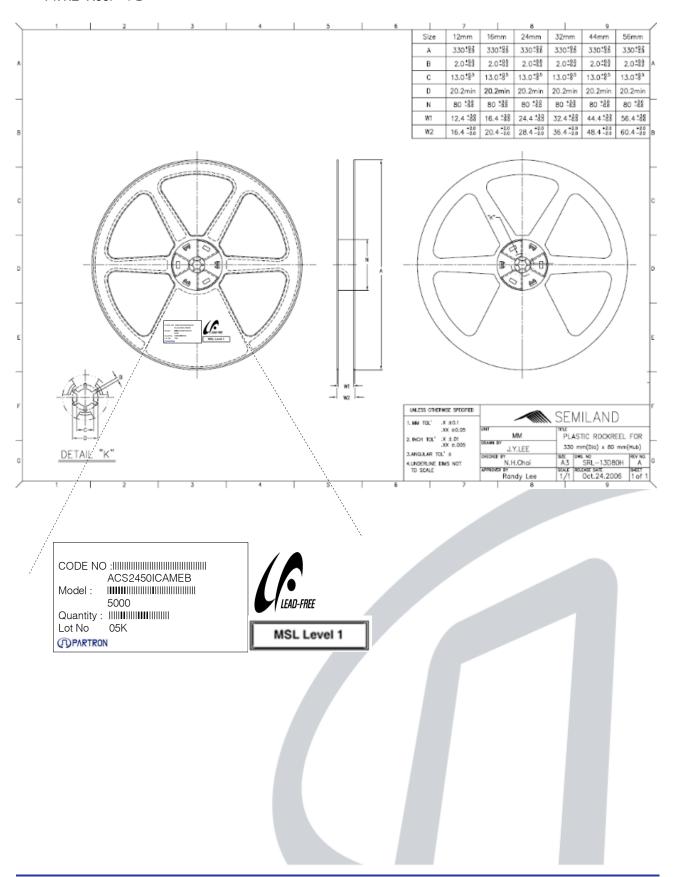
15.1.1 Carrier 사양



Ver 1.0 (2014.12.12) 20/32 Page



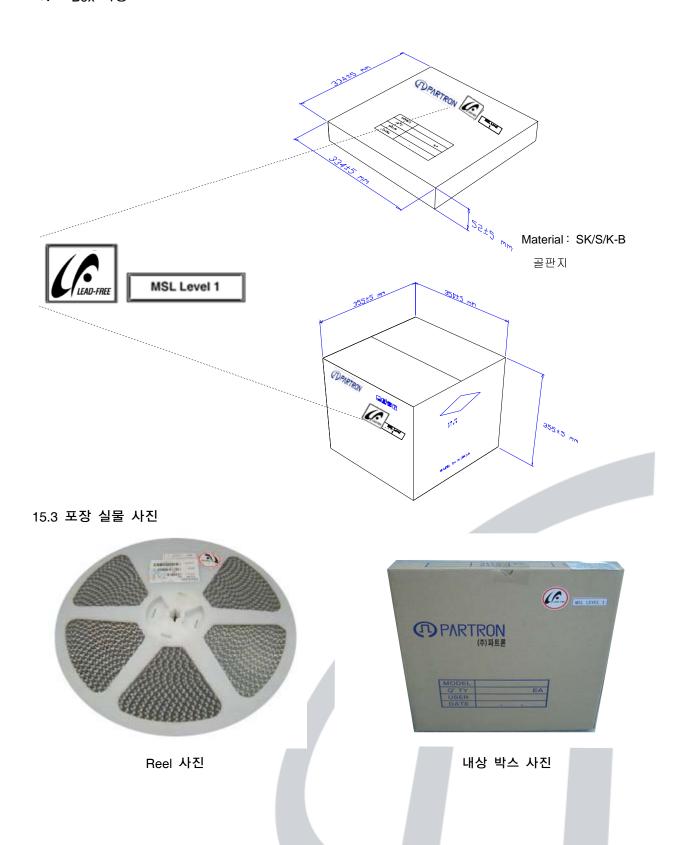
14.1.2 Reel 사양



Ver 1.0 (2014.12.12) 21/32 Page



15.2 Box 사양



Ver 1.0 (2014.12.12) 22/32 Page





외상 박스 사진

CODE NO:

MODEL: ACS2450ICAMEB

QUANTITY: 5000

LOT NO: 05K

MSL LEVEL 1

Reel / 내상 박스 라벨

FROM
PARTRON.CO.LTD
SEKWOO.DONG 22-6
HWASEONG - SI
GYEONGGI - DO
445-170.KOREA



CODE NO:

MODEL: ACS2450ICAMEB



QUANTITY: 30000



DATE: 2010/05/20

LOT NO: 05K

CHIP ANT Partron

외상 박스 라벨





16. 관리공정도

제품			발행 /개정						관리번호	기안	심의		결정	
CHIP ANTENNA		Issued Revised	04.04. d 05.04.		품질관리공정도				PRCP-C00	1				
	FLOW	CHART				요인관리					품질특성관리			
투입자재	준비	본공정	공정명	설비명	관리항독	조건	관리주기	기록관리	관리항목	관리한계	검사방법	관리주기	기록 관리	조치 사항
세라믹 파우더		\Diamond	수입검사						수축율 유전율	작업지도서 참조	Micrometer Network	10개/LOT	C/sheet	반품
파우더 윤활제			분말	Mixer					혼합	파우더: 윤활제	저울	혼합시	-	폐기
			성형 CTQ공정 (무게,치수)	프레스	양압 금형상태	작업지도서 참조	매LOT 1회/일	parameter C/SHEET	치수 무게 밀도 외관	작업지도서 참조	Micrometer 저울 Calculated Visual	5/100개 검사 10개/LOT	LOT CARD	폐기
			소성	소성로	SETTER 오 온도 PROFILE	식입시도시 찬조	전수 2회/일 1회/월	C/sheet						
		\Diamond	소체 CTQ공정 (치수)						폭 길이 모양	검사지도서 참조	Micrometer Calipers 목시	20개/LOT 20개/LOT 전수	C/sheet	폐기
AG PASTE			SIDE1 패드 인쇄 CTQ공정 (인쇄치수)	인쇄기 screen	스퀴즈 속 /압력 SNAP	도 작업지도서 참조	1회/일	_	PATTERN 치수 외관	작업지도서 참조	측정기 현미경	10개/3Jig	c/sheet	재작업
			건조	건조기 건조Jig	온도 Belt spee	작업지도서 참조	1회/주	Parameter	건조상태 인쇄상태 파손	작업지도서 참조	목시	전수검사	Lot card	재작업

Ver 1.0 (2014.12.12) 24/32 Page



	제품			발행 /개정						관리번호	기안	심의		결정
СНІ	P ANTE	ENNA	Issued Revise			품길	일관리 [.]	공정도		PRCP-C00				
FLOW CHART					요인관리					품질특성관리				
투입자재	준비	본공정	공정명	설비명	관리항목	조건	관리주기	기록관리	관리항목	관리한계	검사방법	관리주기	기 록 관리	조치 사항
AG PASTE			SIDE 2 패드 인쇄 CTQ공정 (인쇄치수)	인쇄기 screen	스퀴즈 속5 /압력 SNAP	- 작업지도서 참조	1회/일	_	PATHERNĀ(수 외관	작업지도서 참조	측정기 현미경	107ll /3Jig	c/sheet	재작업
			건조	건조기 건조Jig	온도 Belt speed	작업지도서 참조	1회/주	Parameter	건조상태 인쇄상태 파손	작업지도서 참조	목시	전수검사	Lot card	재작업
			소부	소부로 mesh망	온도 Belt speed	작업지도서 참조	1회/주	Parameter C/Sheet	소체파손 오염	작업지도서 참조	목시	전수	Lot card	폐기 재작업
AG PASTE			TOP 인쇄 CTQ공정 (인쇄치수)	인쇄기 screen	스퀴즈 속5 /압력 SNAP	작업지도서 참조	1회/일	-	PATHETIKS	작업지도서 참조	측정기	10개 /3Jig	c/sheet	재작업
			건조	건조기 건조Jig	온도 Belt speed	작업지도서 참조	1회/주	Parameter	건조상태 인쇄상태 파손	작업지도서 참조	목시	전수검사	Lot card	재작업
AG PASTE			BOTTOM 패드 인쇄 CTQ공정 (인쇄치수)	인쇄기 screen	스퀴즈 속5 /압력 SNAP	- 작업지도서 참조	1회/일	_	PATHENĀ수 외관	작업지도서 참조	측정기 현미경	10개 /3Jig	c/sheet	재작업

Ver 1.0 (2014.12.12) 25/32 Page





제품			ţ	발행 /개정							관리번호	기업	안 심	의	결정	
CHIP ANTENNA			Issued Revised		1.04.06. 품질관리공정도 5.04.03					PRCP-C00	1					
	FLOW	CHART						요인관리					품질특성관	리		
투입자재	준비	본공정	골	공정명	설비명	관리	항목	조건	관리주기	기록관리	검사항목	관리한계	검사방법	관리주기	기록 관리	조치 사항
				건조	건조기 건조Jig	온. Belt s		작업지도서 참조	1회/주	Parameter	건조상태 인쇄상태 파손	작업지도서 참조	목시	전수검사	Lot card	재작업
				소부	소부로 mesh 망	온. Belt s		작업지도서 참조	1회/주	Parameter C/Sheet	소체파손 오염	작업지도서 참조	목시	전수	Lot card	폐기 재작업
		\Diamond	외	관검사							제품외관	한도견본 작업지도서 참조	목시 현미경	전수	Lot card 생산일보	폐기 수리
			MA	ARKING	마킹기						마킹외관	한도견본	목시	전수	Lot card 생산일보	재작업 폐기
		\Diamond	특 C1	성검사 TF공정	NETWORK 검사지그	교정	상태	작업지도서 참조	1회/반	C/sheet	전기적 특성	작업지도서 참조	Network	전수	Lot card 생산일보	폐기 수리
		\Diamond	외	관검사							제품외관 제품치수	한도견본 작업지도서 참조	목시 현미경	전수	Lot card 생산일보	폐기 수리
Carrier cover reel			Т	aping							수량 역삽 외관	작업지도서 참조	수작업	전수	Lot card 생산일보	재작업
		\Diamond	출	하검사	NETWORK 검사지그	교정	상태	작업지도서 참조	1회/반	C/sheet	전기적특성 제품외관 포장상태	검사지도서	Network 현미경 목시	작업 지도서	성적서	return 폐기
포장 box label				포장	bar code printer						포장상태 기종혼입 포장수량	포장작업 지도서	목시	전수	-	재작업
		\Diamond	포	장검사							포장상태 기종혼입 포장수량	포장작업 지도서	목시	전수	_	return

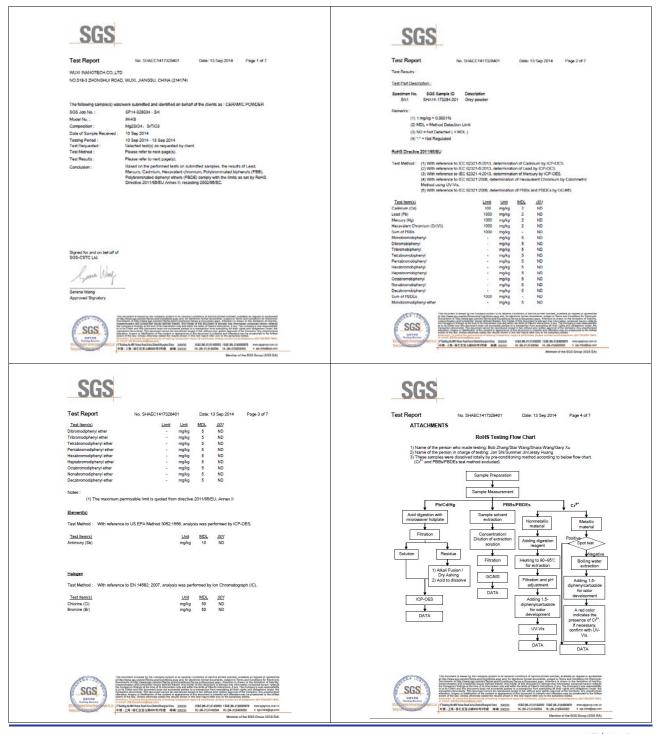
Ver 1.0 (2014.12.12) 26/32 Page



17. 유해물질 성적서

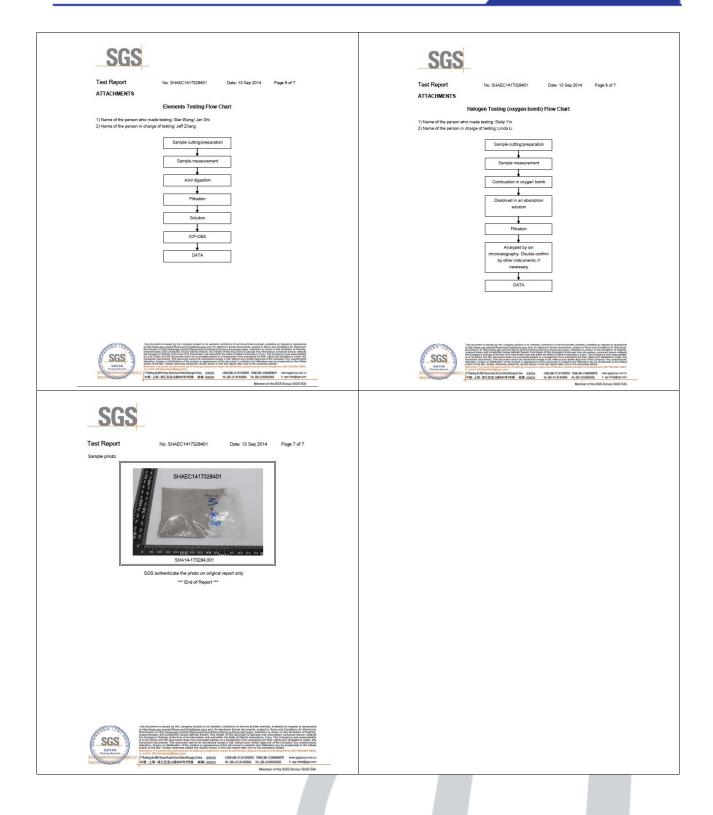
17.1 Ceramic Powder

Parts Name	iM-K8
Tester Organization	SGS Testing KOREA co. Ltd.
Measurement Tester	Please see the 'method' in the test report
Measurement Data	Please see the report under the table



Ver 1.0 (2014.12.12) 27/32 Page





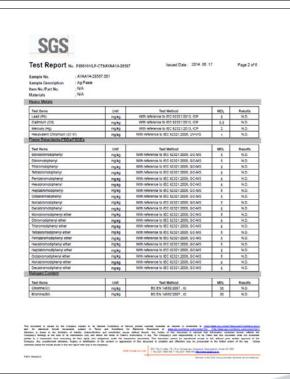
Ver 1.0 (2014.12.12) 28/32 Page



17.2 Ag Paste

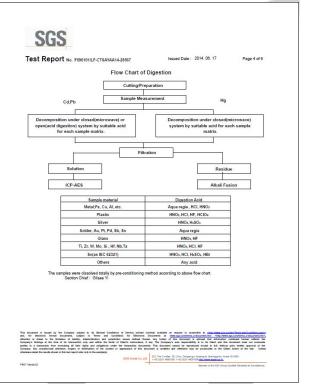
Parts Name	DNF2010C
Tester Organization	SGS Testing KOREA co. Ltd.
Measurement Tester	Please see the 'method' in the test report
Measurement Data	Please see the report under the table







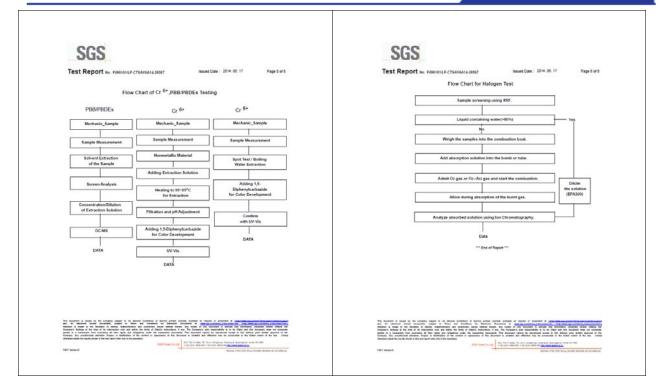
Ver 1.0 (2014.12.12)



29/32 Page









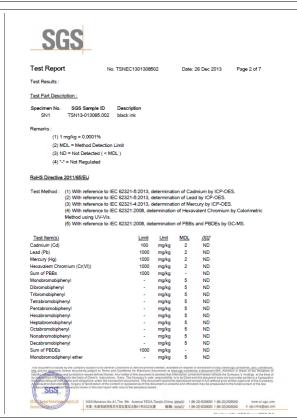
Ver 1.0 (2014.12.12) 30/32 Page



17.3 Marking Ink(Black Ink)

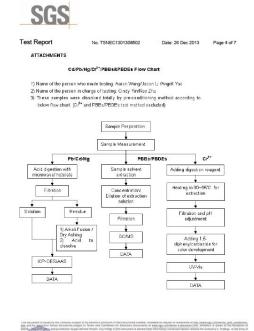
Parts Name	IR/IC-270BK INK
Tester Organization	SGS Testing KOREA co. Ltd.
Measurement Tester	Please see the 'method' in the test report
Measurement Data	Please see the report under the table







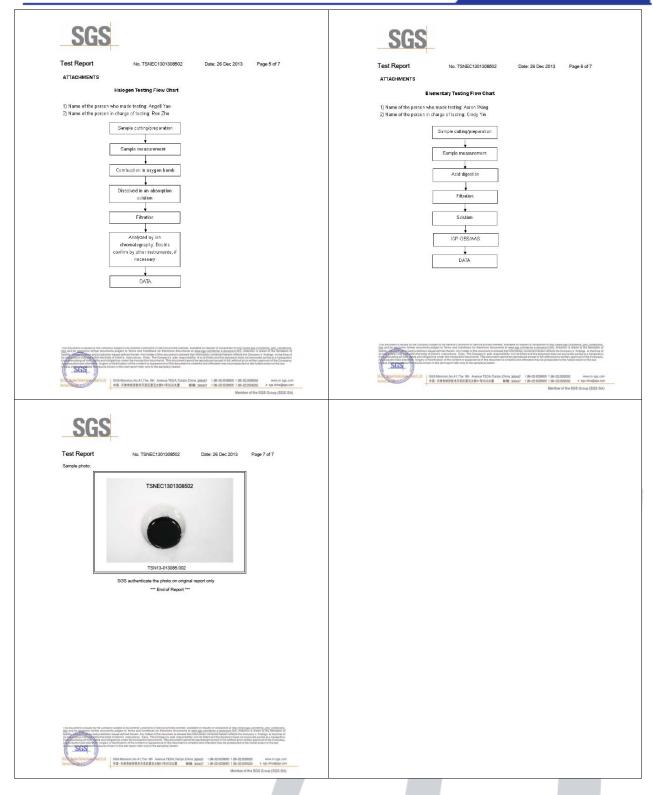
Test Report	No. TSNEC13013085	502	Date:	26 Dec 2013	Page 3 of 7
Test Item(s)	Limit	Unit	MDL	002	
Dibromodiphenyl ether		mg/kg	5	ND	
Tribromodiphenyl ether		mg/kg	5	ND	
Tetrabromodiphenyl eth	r .	ma/kg	5	ND	
Pentabromodiphenyl eth	er .	mg/kg	5	ND	
Hexabromodiphenyl ethi	r	mg/kg	5	ND	
Heptabromodiphenyl eth	er -	mg/kg	5	ND	
Octabromodiphenyl ethe	r e	mg/kg	5	ND	
Nonabromodiphenyl eth	r -	mg/kg	5	ND	
Decabromodiphenyl ethe	r -	mg/kg	5	ND	
Notes :					
(1) The maxi	num permissible limit is quoted from	m directive	2011/65/	EU, Annex II.	
Halogen					
Test Method: With re	ference to EN 14582: 2007, analys	is was per	formed by	/ Ion Chromatog	raph (IC).
Test Item(s)		Unit	MDL	002	
Chlorine (CI)		mg/kg	50	ND	
Bromine (Br)		mg/kg	50	ND	
Element(s)					
	ference to US EPA Method 3052:1	996, analy	sis was p	erformed by ICF	-OES.
Test (tem(s)		Unit	MDL	002	
Antimony (Sb)		mg/kg	10	ND	
Result shown is of the	otal weight of wet sample				
I his cocument is issued by the Com	outy subject to its General Conditions of Service printed with subject to Torms and Conditions for Electronic C for issues defined therein. Any holder of this document	Documents at wy	recego comiters	ns e-document.htm. Atten-	
ton and for accommic formal docu- bodily scapific and jurisdic its in self-fice only self-activities in frequenciating all their Acts and	ths of Client's Instructions, If any, The Company's set bigodium under the transaction documents. This doc yor bigodium of the contentor appearance of this de shown in this test report rater only to the sample(s) test	ument cannot be ocument le union led	reproduced en the effective tube	copt in full, without prior era may be prosecuted to	erition approval of the Co the fullest extent of the I



31/32 Page







Ver 1.0 (2014.12.12) 32/32 Page